

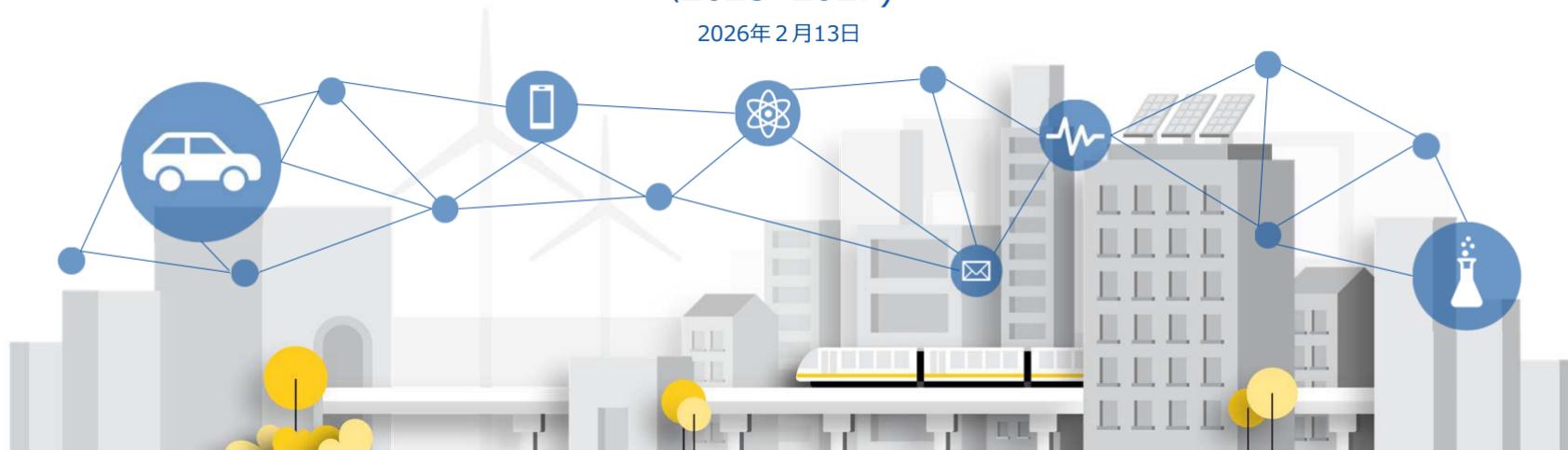
2030年ビジョン

Phase 2 1年目の進捗と今後の取り組み

中期経営計画

(2025-2027)

2026年2月13日



1

2030年ビジョン

2

中期経営計画 Phase2 数値目標見直し

3

中期経営計画 Phase 2

- ① 定性および定量目標
- ② 資本政策
- ③ 人財開発
- ④ 持続可能な社会に向けて



- 生成AI関連の需要拡大など好調な市場環境を背景に「**2030年ビジョンPhase 2**」1年目の業績は当初想定を上回って推移
- 市場環境と高付加価値製品の需要動向を踏まえ、Phase2最終年度である**2027年12月期の目標を修正**
 - ・ 売上高 250億円 ⇒ 250億円
 - コア事業 235億円 ⇒ 245億円
 - 応用展開 15億円 ⇒ 5億円
 - ・ 営業利益率 20%以上 ⇒ 26~30%
 - ・ ROE 10%以上 ⇒ 13~16%
- さらなる株主還元の強化を図るため、Phase 2における配当方針を「**連結配当性向35%以上かつ連結株主資本配当率（DOE）4.0%以上**」に変更

なお、本更新は戦略方針の変更を伴うものではなく、既存の中期経営計画の枠組みの中で、数値目標の見直しを行うものです。

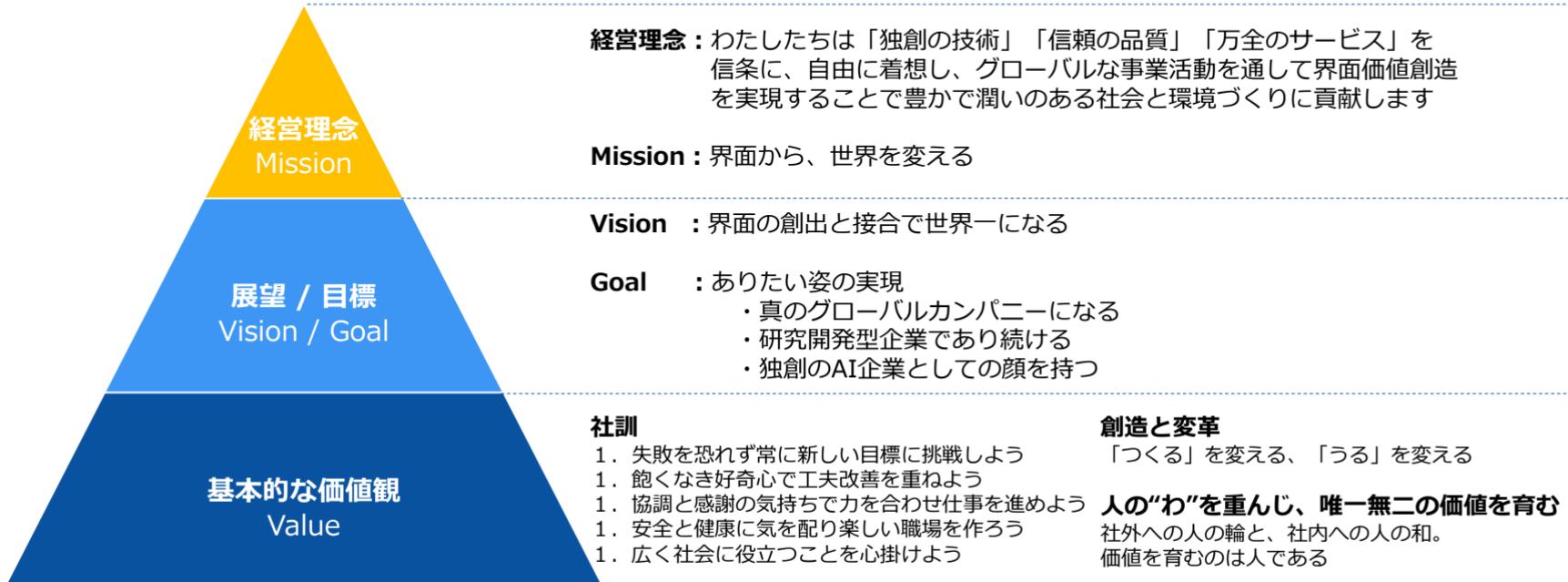
1

2030年ビジョン



社是 (Company motto)

仕事を楽しむ





企業像

- 独創の技術で新たな価値を創造する真のグローバルカンパニーになる
- 研究開発型企業であり続ける
- 独創のAI企業としての顔を持つ



人財像

- 各各自立自走し、連帯できる人財を目指す
- 熱意を持ち、挑戦を続ける人である
- 基本的なデジタルリテラシーを持つ



組織

- 役割に応じて優秀な人財の確保を行い、適正に配置し、
十分に活躍できる環境を準備するよう最善を尽くす

持続的な取り組み

事業活動を通じ、社会課題解決に貢献できる製品・技術を世に提供します。



事業

- 未来を切り開く研究開発
- 環境負荷低減製品の開発
- 適正の調達、生産、物流



環境

- 気候変動対応
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 品質保証



社会・労働

- 労働安全・健康経営
- ワークライフバランス
- キャリア形成
- ダイバーシティ
- エンゲージメント



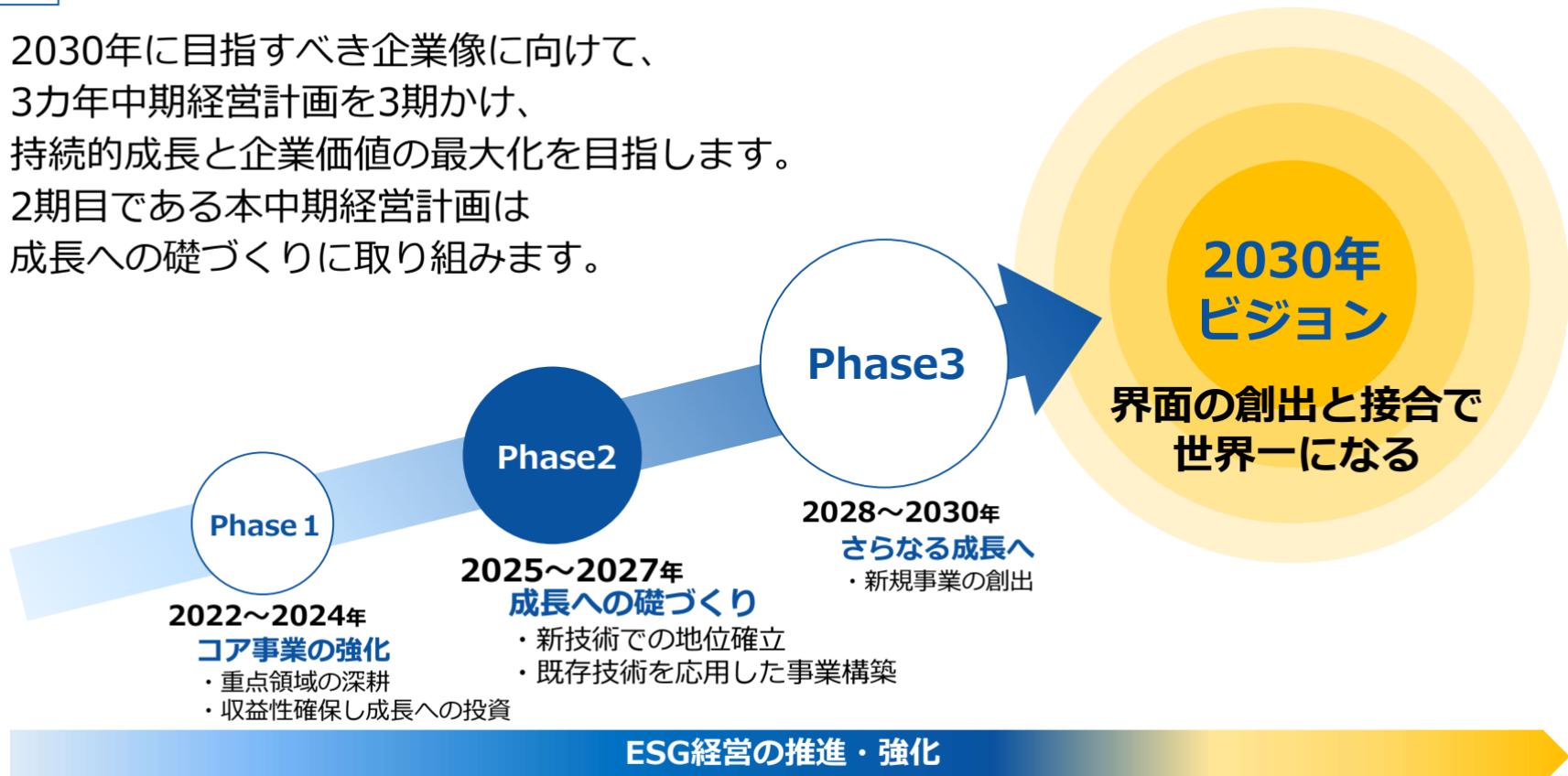
ガバナンス

- コーポレート・ガバナンスの強化
- リスクマネジメント強化
- コンプライアンスの徹底
- 情報セキュリティ



本中期経営計画の位置づけ

2030年に目指すべき企業像に向けて、
3カ年中期経営計画を3期かけ、
持続的成長と企業価値の最大化を目指します。
2期目である本中期経営計画は
成長への礎づくりに取り組みます。



2030年の社会

通信情報革命により、デジタル技術が急速な発達が見込まれています。



次世代通信
ネットワーク

5G/6G、光通信、衛星通信



IoT

あらゆるものがネット接続



AIの多様化

情報処理に人工知能を応用、DX、ロボット



次世代モビリティ

自動運転車、自動運転アシストシステム

中期経営計画 Phase2

数値目標見直し

2



定量目標と実績

当社グループが属する市場環境と当社高付加価値製品の需要動向を踏まえ、収益性および資本効率に関する経営目標を明確化します。

2025年12月期 実績

2027年12月期 当初目標

2027年12月期 修正目標

売上高

209億円**250億円**コア事業
応用展開
235億円
15億円**250億円**コア事業
応用展開
245億円
5億円営業
利益率**27.4%****20%以上****26～30%**

ROE

17.5%**10%以上****13～16%**

3

中期経営計画 Phase2



当社における重要機会

拡大する市場



次世代通信ネットワーク
(5G/6G、光通信、衛星通信)



IoT
(あらゆるモノがネット接続)



AIの多様化
(DX、エッジAI、ロボット、医療等)



次世代モビリティ
(自動運転車、運転アシストシステム等)

求められる技術



高速情報処理



低電力消費



小型化



信号低損失

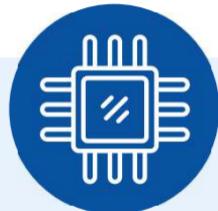


高集積ニーズ拡大

コア事業の**市場拡大**
(半導体、電子基板市場)



超微粗化、無粗化技術による
密着向上剤の需要拡大
(信号高速化、高密度化)



半導体パッケージ (コア事業の拡大)

信号低損失、高集積化による
適用技術の変化

最終製品例

データセンター、通信インフラ、ロボット、
パソコン、車載等



高速・情報通信 (新技術領域の開拓)

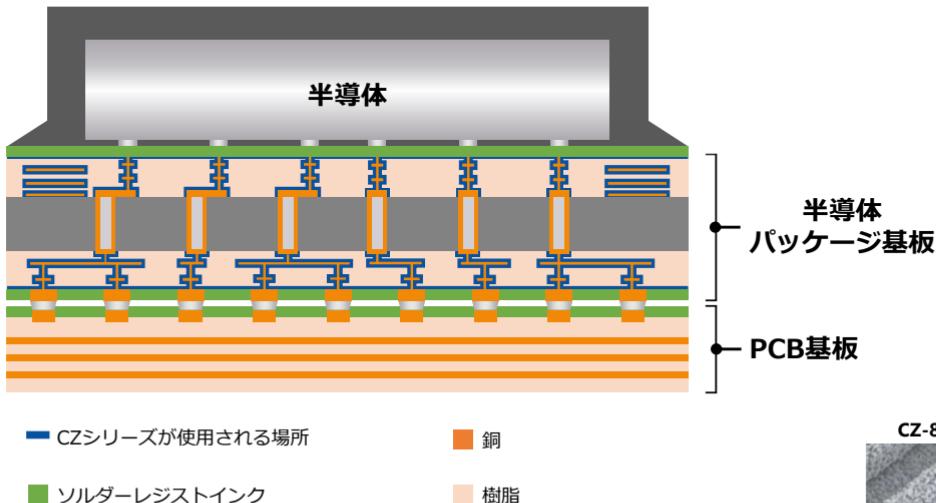
信号低損失、高集積化による
適用技術の変化

最終製品例

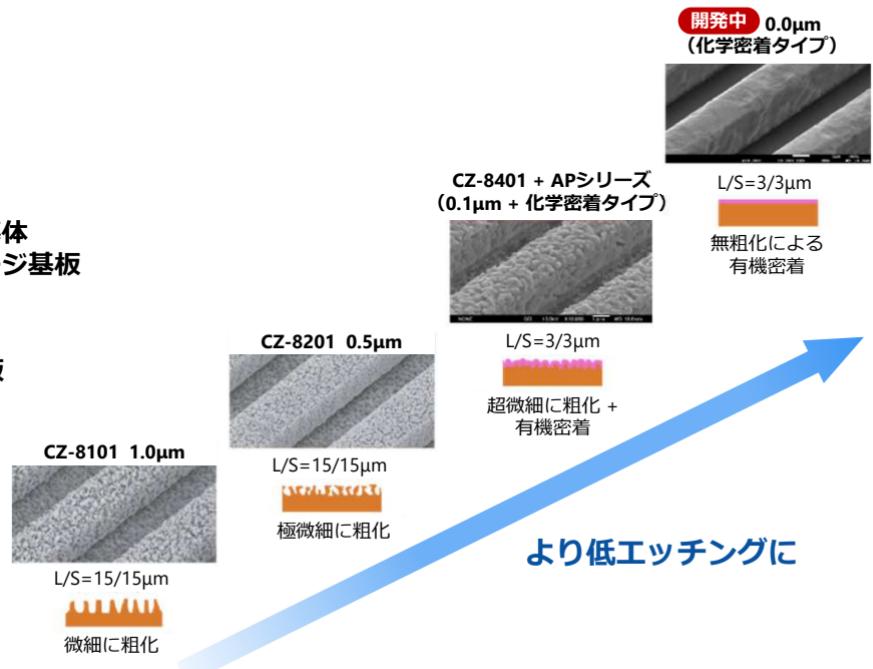
データセンター、通信インフラ、ロボット、
パソコン、車載等

当社の強み 層間密着技術

主力製品「CZシリーズ」は、銅と樹脂との密着が求められる界面で貢献しています。
半導体パッケージ基板の銅とビルドアップ樹脂との密着向上プロセスで欠かせない技術です。

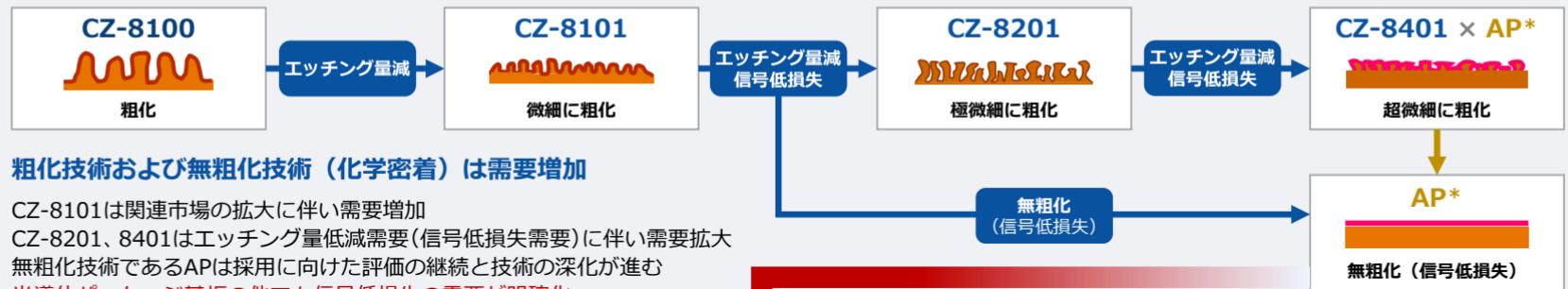


半導体パッケージ基板が大型化・高多層化
⇒ CZシリーズの使用量増加



銅密着表面技術の変遷

コア事業：半導体パッケージ基板



粗化技術および無粗化技術（化学密着）は需要増加

CZ-8101は関連市場の拡大に伴い需要増加

CZ-8201、8401はエッティング量低減需要（信号低損失需要）に伴い需要拡大

無粗化技術であるAPは採用に向けた評価の継続と技術の深化が進む

半導体パッケージ基板の他でも信号低損失の需要が明確化

~60

40

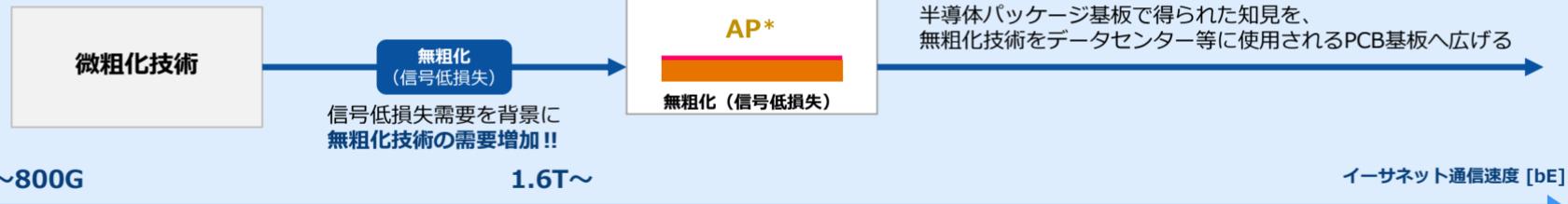
20

10

最小ライン幅 [μm]

0

応用展開：PCB基板（高周波基板）



微粗化技術

無粗化
(信号低損失)

信号低損失需要を背景に
無粗化技術の需要増加!!

~800G

1.6T~

イーサネット通信速度 [bE]

* AP : Adhesion Promotor 無粗化技術による化学密着、微粗化に対する化学密着補強

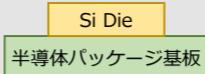
コア事業：半導体パッケージ基板の既存領域における取り組み

半導体パッケージ基板の進化によって当社製品の使用量の増加を見込みます。

半導体パッケージ基板を取り巻く流れ

通常のパッケージ基板

一つのパッケージに
一つの半導体



先端パッケージ基板

Chiplet、2.X/3D
パッケージを大きくし
複数の半導体を搭載

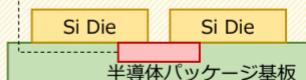


先端パッケージ基板の例

EMIB

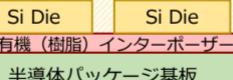
Embedded Multi-die Interconnect Bridge

Siブリッジ



CoWoS

Chip on Wafer on Substrate



当社の取り組み

豊富な製品ラインナップを活かして先端
半導体パッケージ基板の課題を解決する製品を提供

CZ・APシリーズで課題を 解決

半導体パッケージ基板の

- 高密度化
- サイズ大型化
- 高多層化

APシリーズ

CZ-8401

CZ-8201

CZ-8101

化学密着

機械密着

技術サポートを通じて適切な製品を顧客に提案



課題を解決する製品提案



定期的なコンタクトによる
課題把握

応用展開：高周波基板における取り組み

高速通信の進展を背景に、高周波特性を備えた基板の成長を見据え、次世代技術における技術優位性の確立に向けた製品開発を推進します。

高周波基板を取り巻く流れ

現在の主流

800ギガイーサネット

Gigabit
800G



データトラフィックの増加に伴う
データ処理の高速化の必要性

2027年以降に本格的な立ち上がりの見込み

1.6テライーサネット

Gigabit
1600G



電気信号を高速化し、
データ処理の高速化を目指す

現状の技術

銅の表面を
粗化

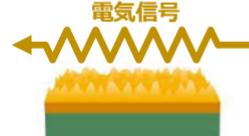


有機被膜で
銅と樹脂を密着

● 技術的な課題

銅表面に粗化による凹凸があるため

△ 伝送損失が
大きい



当社が目指すこと

APシリーズ

有機被膜のみで銅と樹脂を密着

● 開発の方向性

- ・表面処理のロス低減
- ・多様な基材・プロセスに使用できる
汎用性の向上

OEMや顧客からの評価による改善を進める

● 期待できる効果

銅表面に粗化による凹凸がないため

○ 伝送損失が
小さい



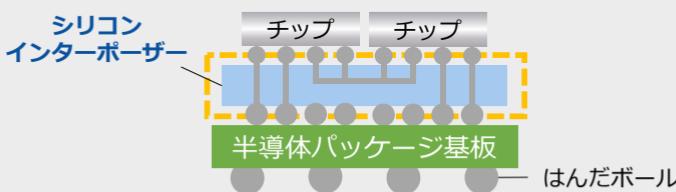
応用展開：インターPOーラーにおける取り組み

MIEC

大型化・高密度化の進展を背景に、インターPOーラーの構造変化を見据え、次世代技術における技術優位性の確立に向けた製品開発を推進します。

インターPOーラーを取り巻く流れ

現在はシリコンインターPOーラーが主流



製造コストの削減に向け
有機材料（樹脂）の
インターPOーラーの
開発が進展

処理能力増に向けた
大型化が進展

銅と樹脂の密着度が高い
当社製品が貢献できる領域の拡大

当社の取り組み

既存製品を活用してインターPOーラーの進化に
対応するための製品開発を推進

CZ・APシリーズで課題を
解決

インターPOーラーの
樹脂化・大型化に伴い
「反り」が発生

APシリーズ

化学密着

CZ-8401

機械密着

その他、当社技術の参入機会の可能性に向けた取り組み

JOINT3

次世代半導体パッケージのコンソーシアム
「JOINT3」に参画

目的

参画企業との共創により、パネルレベル有機インターPOーラーに
適した材料・装置・設計ツールの開発を加速

メックの役割

層間密着強化による高集積化への貢献等

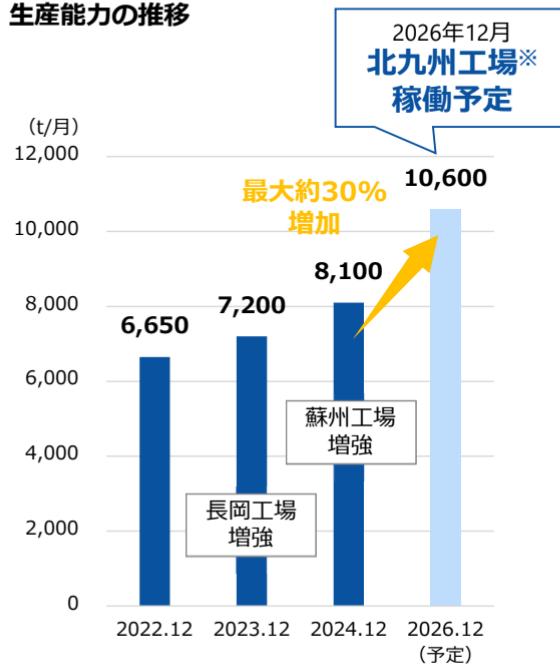
参画企業

27社（2025年9月3日時点）

グローバル供給能力強化

今後の当社製品の需要増加を見据え、安定供給体制を強化します。

生産能力の推移



北九州工場※の概要

生産能力を増強し、CZシリーズに加え、APシリーズの量産にも対応

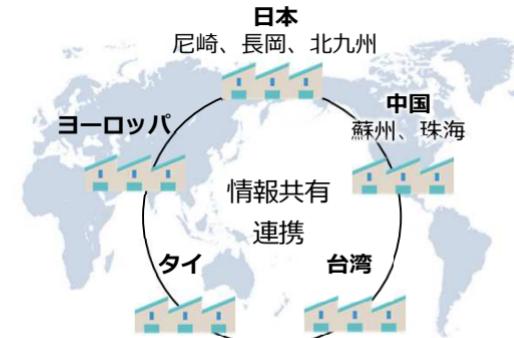


(イメージ)

- 2026年12月稼働予定
- 総投資額は約47億円（土地含む）
- 最大生産能力は、年間3万トン予定
- 地政学リスクが高まるなかサプライチェーンの安定にも寄与

グローバル生産体制の強化

従来、各生産拠点視点で構築していた目線をメックグループとして最適化し、グローバル視点での生産体制を強化する



主力製品の今後の見通し

		特徴	最終製品例	売上見通し
密着向上剤	APシリーズ (化学密着タイプ)	<ul style="list-style-type: none"> エッティングや表面粗化を伴わず、銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 伝送損失が少なく、半導体パッケージ基板や高周波基板に使用される。 	<ul style="list-style-type: none"> データセンター 通信基地局 自動運転車 電気自動車 ロボット パソコン スマートフォン タブレットPC 	
	CZシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> 銅表面に低エッティングによる独特の凹凸形状を形成し、銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 主に半導体パッケージ基板向けの密着向上剤で、高密度PCB基板にも使用される。 	<ul style="list-style-type: none"> 自動車 スマートフォン 衛星通信 	
	CZ-8401			
	CZ-8201			
	CZ-8101			
エッティング剤	CZ-8100			
	V-Bondシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> 銅表面にエッティングによる独特の凹凸形状を形成し、銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、半導体パッケージ基板には使用されない。 	<ul style="list-style-type: none"> テレビ・スマートフォン等のディスプレイ 	
	EXEシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> サブトラクティブ工法で微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッティング剤として使用される。 	<ul style="list-style-type: none"> タブレットPC 	
SFシリーズ				
		<ul style="list-style-type: none"> 銅への選択性を持ったエッティング剤。 		

中期経営計画 Phase2

3

① 定性および定量目標



定量目標

連結売上高

2027年

250 億円

[
コア事業 245億円
応用展開 5億円
]

連結営業利益率※

26~30%

ROE※

13~16%

定性目標

既存市場における収益性維持・強化

- 顧客との関係性強化
- 超微粗化系密着向上処理のシェア維持
- 無粗化技術（化学密着）領域におけるソリューション確立
- 環境配慮薬品への取り組み

既存技術の応用展開分野における事業構築

新規事業の創出

グローバル安定供給体制の確立

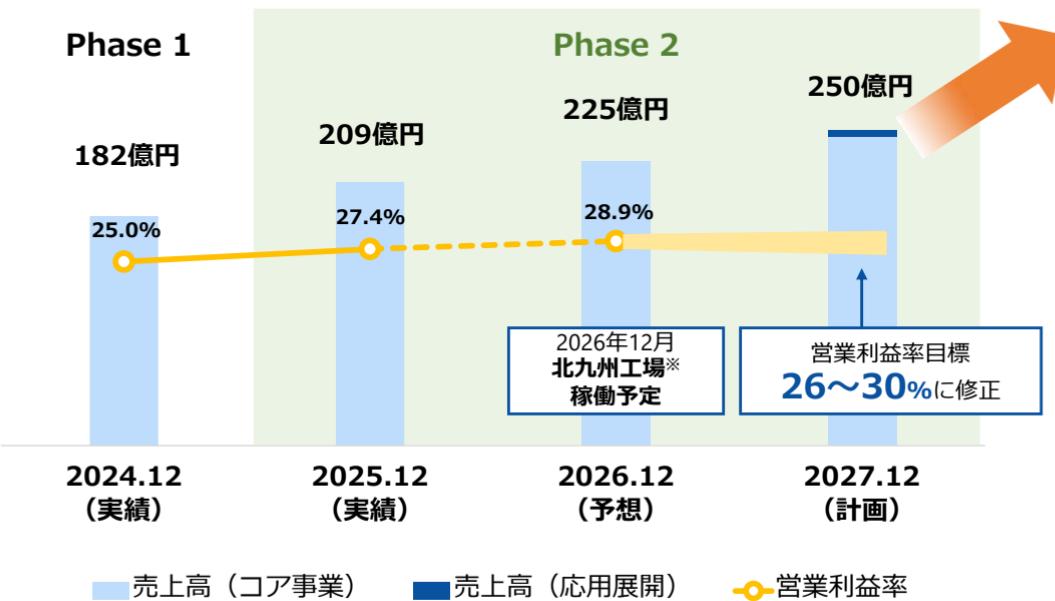
ESG経営の推進・強化

2030年ビジョン達成に向けたロードマップ

MIEC

半導体市場の拡大に伴う旺盛な需要に対応するため、
新技術領域開拓および生産能力増強を行い、中長期の飛躍を目指します。

売上高・営業利益率の実績と計画



さらなる
トップライン成長と
利益率向上の実現を目指す

営業利益率目標変更の理由

- 生成AI関連の需要拡大に伴い
高付加価値品の需要が拡大。
- 半導体関連の需要は旺盛で、
今後も堅調な需要が見込まれる。

北九州工場※稼働による費用増加

- 2027年12月期は試験運用や立上げ対応のため
費用の先行発生を見込む

中期経営計画 Phase2

3

② 資本政策

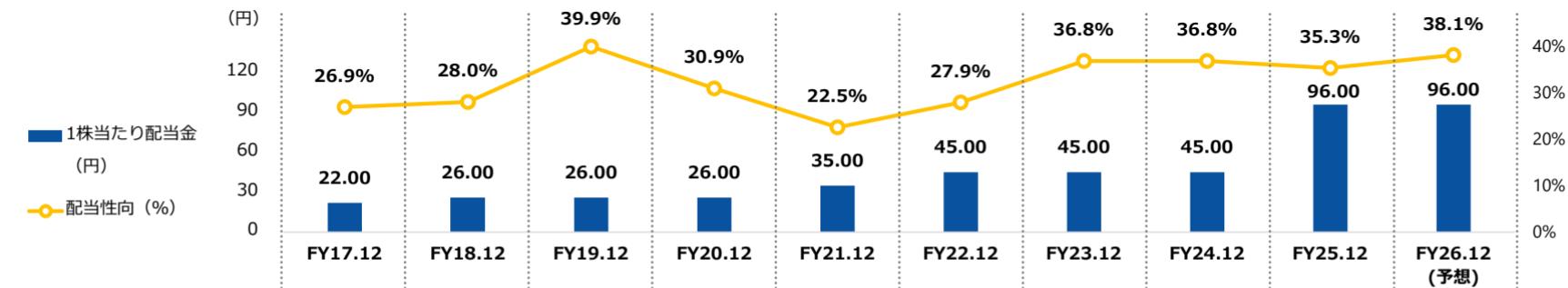


株主還元方針の変更

より安定的な配当と株主還元の強化を図るべく配当方針を変更し、自己株式取得は、従来どおりキャッシュ・アロケーションの進捗などを踏まえながら機動的に実施します。



配当金および配当性向の推移

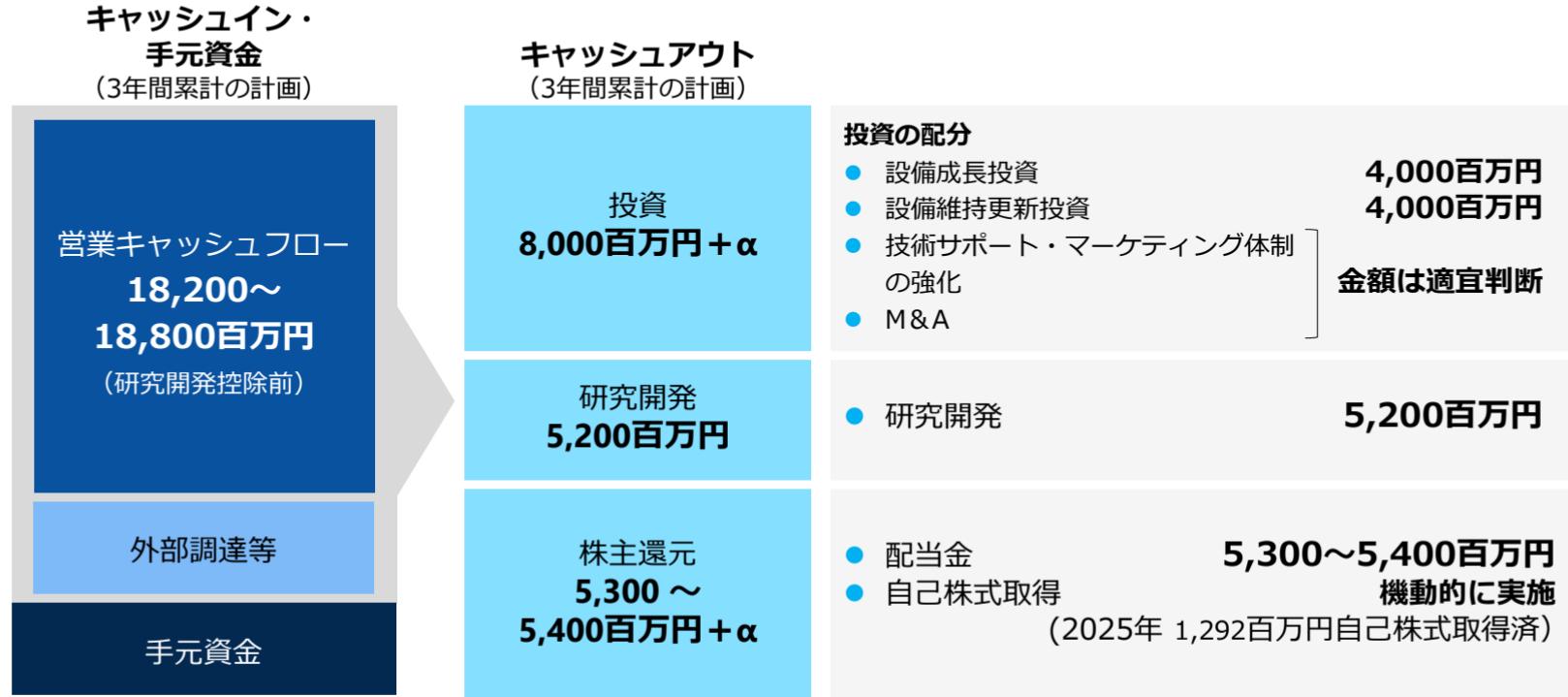


DOE	3.1%	3.4%	3.2%	3.0%	3.5%	3.9%	3.5%	3.3%	6.2%	5.6%
自己株式取得 (百万円)	-	265	-	-	-	-	900	-	1,292	-

キャッシュ・アロケーション 基本方針

MIEC

Phase2（2025～2027年累計）のキャッシュ・アロケーションの基本方針を示します。



※各項目の大きさはその額の大きさを示すものではありません。

中期経営計画 Phase2

3

③ 人財開発



挑戦できる企業風土の実現

多様な個性・価値観を有する人財が、自立自走・連帯のもと、「創造と変革」に挑戦できる企業風土を醸成します。

キャリア形成と能力開発支援

従業員一人ひとりの持続的成長のために必要な教育・研修機会を提供し、キャリア形成と能力開発を支援します。

ダイバーシティの推進

「多様な人財の獲得」「公正な評価で報いる人事制度の構築」「効果的な人財配置を実現するタレントマネジメントシステムの充実」による、働き甲斐のある労働環境づくりに取り組みます。

従業員エンゲージメントの向上

多様な人財を受容する制度整備・意識変革を推進し、ワークライフバランスの充実による、従業員エンゲージメントの向上を実現します。

良好な社内環境の構築

従業員一人ひとりが心身ともに健康で、安全にいきいきと働き続けることができる良好な社内環境を構築します。

目標（2030年）

女性管理職比率

30%以上



男女賃金差異※

90%以上



男性育児休業取得率

85%以上



※男性従業員を100とした場合の女性従業員の賃金水準。

当社では賃金体系を職位により設定しており、性別による賃金格差でなく、同職位における男性、女性の賃金は同一です。発生している格差は職位ごとの性別構成比の差に起因しています。

中期経営計画 Phase2

3

④ 持続可能な社会に向けて



当社グループは、「環境保全」に関する気候変動問題への対応として2030年の定性的目標に次の2つを掲げています。

- 社会の持続的な成長のため、地球環境問題に真摯に取り組む
- エネルギー使用の削減とネットゼロに向けての取り組みを実施

具体的に、
次のようにCO₂削減目標を
定め取り組んでいます。



2030年度までに
国内のScope1・2の総排出量
実質50%削減
(基準年度：2017年度)

Appendix



メックが社会に提供する価値



電子基板の高性能化、小型化・軽量化、通信伝送の超高速化、信頼性の向上を支える化学薬品を供給し、人々の豊かな暮らしを支えています。

当社の技術はさまざまな電子機器に貢献



通信基地局



サーバー・
スパコン



パソコン・
スマートフォン



ロボット



輸送機器



医療機器



ディスプレイ



メックのソリューション

電子基板の性能向上

銅と樹脂基板の
密着性向上

樹脂基板の
微細配線形成

銅の
表面の化学処理

高性能化

小型化・軽量化

省電力化

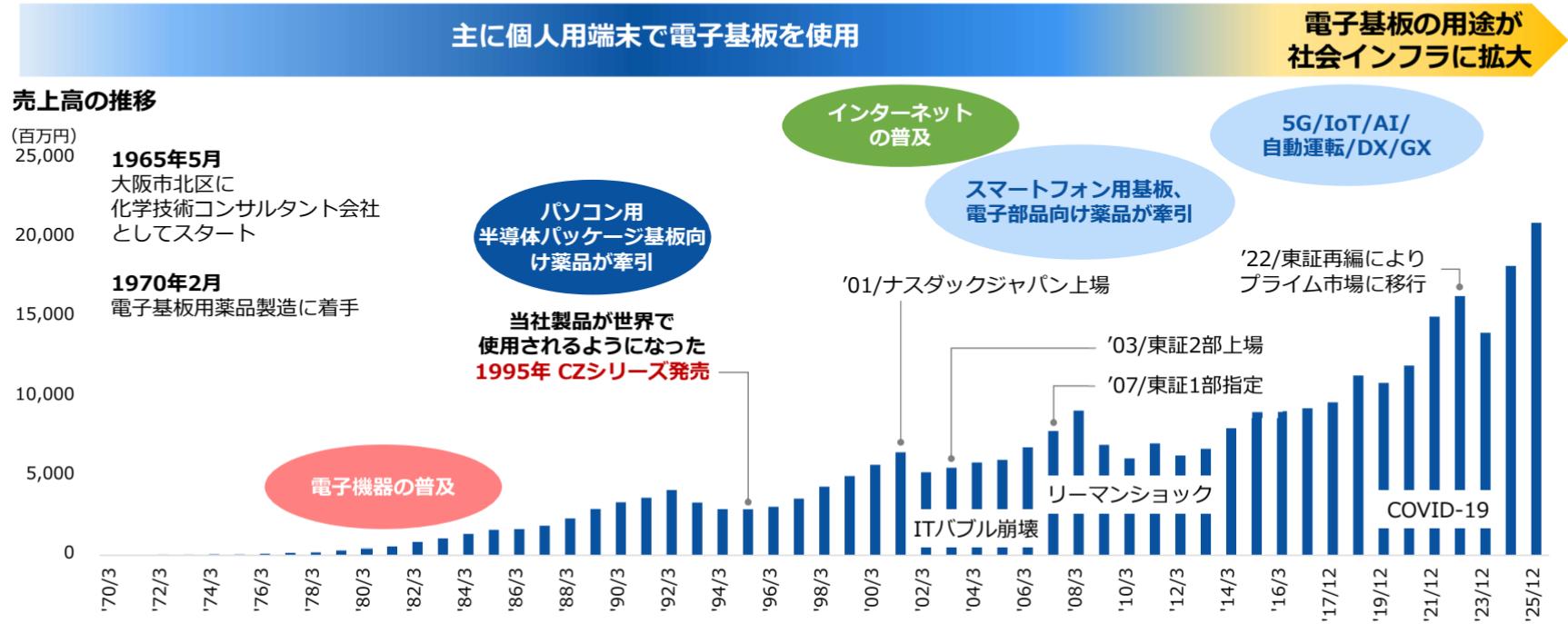
通信伝送高速化

信頼性向上

成長の軌跡

MIEC

電子基板の用途が拡大するなか、市場のニーズをとらまえユニークな製品とサービスを提供しつづけ成長しています。



※2017年12月期（第49期）は、決算期変更により2017/4/1～12/31までの9カ月。なお、連結対象期間については、当社は9カ月間（2017/4/1～12/31）、連結子会社は12カ月間（2017/1/1～12/31）。

メックのコア技術

「密着向上」 「配線形成」 「選択エッチング」 の技術で、界面価値創造を実現します。

表面を粗化し、機械的に密着性を向上



表面を粗化せず、化学的に密着性を向上



配線を形成する



選択エッチング

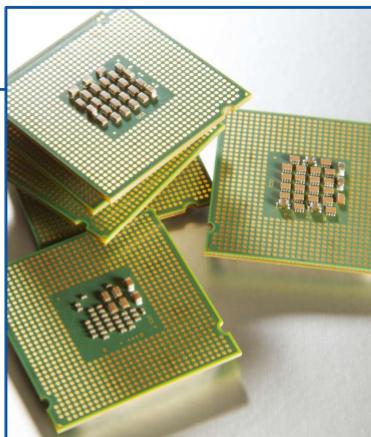


独自の技術力により、世界で独占的シェアを確立



銅と樹脂の密着性を高める超粗化剤で、半導体パッケージ基板において世界市場における独占的シェアを確立。世界中の電子基板・部品メーカーなど、300社以上の顧客から評価・支持されています。

層間密着向上プロセスにおける世界的シェア



- 高い密着性と信頼性が認められ、先行してシェアを確保
- 30年以上の使用実績があり、CZ起因のエラーはゼロ
- 顧客ニーズや市場状況を把握し、継続的な製品改良を実施

界面価値創造

Creating and Fostering Value at Various Interfaces

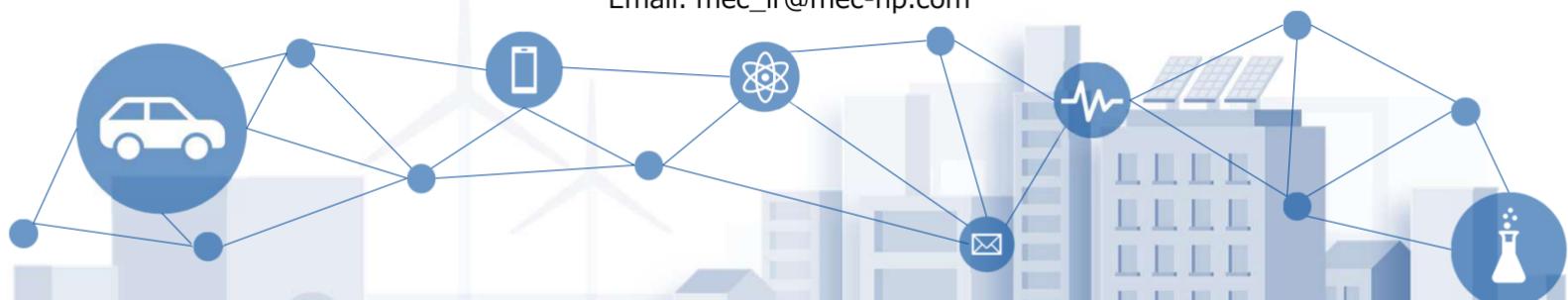


<https://www.mec-co.com/>

【連絡先】メック株式会社 コーポレートコミュニケーション室

Tel. 06-6401-8160

Email. mec_ir@mec-np.com



このプレゼンテーション資料には、2026年2月13日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。